
未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱「業務－我們的戰略」。

所得款項用途

假設[編纂]未獲行使，且[編纂]為每股[編纂]港元（即本文件所述指示性[編纂]範圍的中位數），於扣除我們就[編纂]應付的[編纂]、費用及估計開支後，我們預計[編纂]的[編纂]約為[編纂]港元。

根據我們的戰略，我們擬將[編纂]用於以下用途，但會根據我們不斷發展的業務需求和不斷變化的市場情況而有所變化：

- [編纂]中約[編纂]%（即約[編纂]港元）將撥款用於研發計劃，旨在推動技術創新與迭代，豐富及優化產品組合，並建立多維度產品矩陣。我們認為，有關投資將使我們能夠拓寬芯片產品和SoC解決方案範圍，擴大終端應用範圍，並把握智能車載、機器人、AI眼鏡及移動影像設備等新興市場的機遇，同時將推動技術快速進步，有助我們保持行業領先地位。具體包括：
 - (i) [編纂]中約[編纂]%（或約[編纂]港元）將用於視覺AI SoC的開發。[根據弗若斯特沙利文的資料，全球視覺AI SoC出貨量預計將從2024年的人民幣246.0百萬元增長至2029年的人民幣954.3百萬元，複合年增長率為31.1%，主要受不同場景端邊側設備對視覺智能的需求快速增長推動，包括智能安防、機器人、智能車載和移動影像設備如AI眼鏡等。我們的目標是持續推進視覺AI SoC的研發，將AI能力全面融入所有視覺SoC，對現有產品進行更新升級，並根據市場需求推出新的SoC型號，確保我們緊跟技術創新步伐並保持市場相關性。尤其是，我們旨在持續強化核心IP及SoC設計能力，並力求在運動ISP、NPU、高分辨率與高幀率視頻編解碼、低功耗架構及先進製程節點SoC技術等領域取得針對性突破。我們相信此有助我們建立專為不同市場需求及多元應用場景而設的高、中、低端邊側版本SoC產品組合，從而增強我們的視覺AI SoC組合，鞏固我們在端邊側AI應用時代的領導地位。

我們認識到半導體行業屬高度人才密集型行業，計劃保留、擴充及加強研發團隊。我們計劃在未來五年內吸引並保留約109名額外研發人才，具備相關知識及專業技能，並招聘擁有相關學位的頂尖高校人才。此外，[編

未來計劃及[編纂]用途

[纂]將用於支持視覺AI SoC的關鍵研發活動，並支付相關成本及開支，包括IP及軟件授權費、芯片流片光罩與材料費用，硅前驗證服務費，以及測試儀、仿真系統及服務器等主要設備的購置。

- (ii) [編纂]中約[編纂]% (或約[編纂]港元) 將用於3D感知SoC (主要為LiDAR SPAD SoC) 的開發。根據弗若斯特沙利文的資料，全球LiDAR SPAD SoC出貨量預計將從2024年的人民幣0.4百萬元增長至2029年的人民幣12.3百萬元，複合年增長率為98.4%，主要歸因於SPAD-SoC的獨特優勢以及汽車、機器人及工業場景中LiDAR出貨量不斷增加。LiDAR SPAD-SoC對於我們拓寬產品組合範圍、提升下一代感知解決方案的交付能力至關重要。我們計劃持續開展LiDAR SPAD SoC的研發，聚焦提升數據採集速度、低功耗、微型化及系統集成，引入前後向長距雷達、短距補盲雷達SoC等全新3D感知SoC，並建立高、中、低端的全系列產品矩陣，以滿足市場需求。

為此，我們擬在未來五年內通過吸引和留住大約27名額外的研發專業人員來擴大和加強我們的研發團隊，彼等具備相關知識及專業技能。同時，我們還尋求招募擁有相關學術背景的頂尖高校人才。[編纂]還將用於為必要的研發活動提供資金以開發3D感知SoC，並支付相關成本及開支。

- [編纂]中約[編纂]% (或約[編纂]港元) 將用於戰略投資及／或收購，以實現長期增長目標，並進一步鞏固我們的整體競爭地位。我們將重點關注產品與技術能在技術、應用場景及市場發展三個層面上與我們的現有產品組合形成強勁協同效應或構成重要補充的公司並把握相關機遇。在技術方面，我們計劃收購核心IP資產及關鍵技術，以彌補缺口、加強我們的技術護城河、協助我們縮短研發週期並緊貼AI模型的快速變化，同時結合我們的3D感知及連接能力，提供經優化的端到端解決方案及更卓越的系統性能。在應用場景方面，我們預期這些投資及收購將有助我們進入新的應用場景及行業垂直領域，加深於現有領域的滲透率，並透過將我們的SoC與互補產品及解決方案配對，加強交叉銷售能力，全面滿足客戶需求。在市場發展方面，戰略收購行業解決方案供應商及其他生態系統合作夥伴，預期將加快我們進入目標市場的步伐，提升接觸核心客戶的能力，並增強我們的產品支援及服務能力。我們相信此舉將能提升我們向客戶提供「感知+計算+連接」軟硬件集成一站式解決方案的能力。截至最後實際可行日期，我們尚未確定任何具體收購或投資目標，亦未訂立任何投資協議以使用該等[編纂]。具體而

未來計劃及[編纂]用途

言，預期我們的潛在投資併購目標須滿足以下條件：(i)擁有強大的技術能力，能夠與我們的技術相輔相成、相互增強，從而實現更強的技術協同效應，並進一步豐富我們的核心IP庫；(ii)推出能夠優化現有產品組合、填補產品結構空白的產品，從而擴大客戶群、促進進入新應用場景並把握新的增長機遇；(iii)擁有成熟、經過市場檢驗的產品，能夠快速推動我們新興業務領域的發展並加速市場滲透；及(iv)目標公司的管理團隊應擁有IC設計行業的相關知識及豐富經驗；

我們對司法管轄區不設限制，並將評估上游及下游各領域的投資機會，短期內的重點領域包括射頻連接、AI算法、基礎模型、高性能運算、具身智能、自動駕駛、邊緣計算及AI推理。

根據弗若斯特沙利文的資料，滿足我們上述選擇標準的潛在投資併購目標目前超過200項。

- [編纂]中約[編纂]% (或約[編纂]港元)將用作運營資金和其他一般企業用途的補充，為我們提供足夠的財務靈活性，以應對持續運營需求並在不可預見的情況下保持穩定性。

下表載列我們擬定[編纂]用途的預期實施時間表：

	[編纂]至 12月31日期間		截至12月31日止年度			總計
	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
	(百萬港元)					
研發						
開發視覺AI SoC						
挽留、擴大及強化我們的研發團隊	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
流片開支	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
其他研發開支	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
小計	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
開發3D感知SoC						
挽留、擴大及強化我們的研發團隊	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
流片開支	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
其他研發開支	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
小計	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

